



平成23年4月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成22年9月9日

上場会社名 インスペック株式会社

上場取引所 東

コード番号 6656 URL <http://www.inspec21.com>

代表者 (役職名) 代表取締役社長兼代表執行役員

(氏名) 菅原 雅史

問合せ先責任者 (役職名) 取締役兼執行役員管理部長

(氏名) 富岡 喜栄子

TEL 0187-54-1888

四半期報告書提出予定日 平成22年9月14日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成23年4月期第1四半期の業績(平成22年5月1日～平成22年7月31日)

(1) 経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
23年4月期第1四半期	227	778.5	13	—	9	—	8	—
22年4月期第1四半期	25	△84.9	△62	—	△62	—	△61	—

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
23年4月期第1四半期	823.28	—
22年4月期第1四半期	△5,794.91	—

(2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
23年4月期第1四半期	1,059	270	25.5	25,344.19
22年4月期	967	261	27.0	24,520.91

(参考) 自己資本 23年4月期第1四半期 270百万円 22年4月期 261百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
22年4月期	—	0.00	—	0.00	0.00
23年4月期	—	—	—	—	—
23年4月期(予想)	—	0.00	—	0.00	0.00

(注) 当四半期における配当予想の修正有無 無

3. 平成23年4月期の業績予想(平成22年5月1日～平成23年4月30日)

(%表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	430	121.5	△10	—	15	—	15	—	1,406.73
通期	900	62.2	10	—	50	—	50	—	4,689.11

(注) 当四半期における業績予想の修正有無 無

4. その他（詳細は、[添付資料]3ページ[その他の情報]をご覧ください。）

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 有

(注)簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

(注)「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。

(3) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年4月期1Q 10,663株 22年4月期 10,663株

② 期末自己株式数 23年4月期1Q 一株 22年4月期 一株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年4月期1Q 10,663株 22年4月期1Q 10,663株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続を実施しています。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想には、発表日現在において入手可能な情報から得られた判断に基づいております。予想には様々の不確定要素が内在しており、実際の業績には様々な要素によりこれらの業績予想とは異なる場合があります。業績予想に関する事項は、[添付資料]2ページ[業績予想に関する定性的情報]をご覧ください。

添付資料の目次

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する定性的情報	2
(2) 財政状態に関する定性的情報	2
(3) 業績予想に関する定性的情報	2
2. その他の情報	3
(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要	3
(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要	3
(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要	3
3. 四半期財務諸表	4
(1) 四半期貸借対照表	4
(2) 四半期損益計算書	5
(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書	6
(4) 継続企業の前提に関する注記	7
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	8

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

当第1四半期累計期間における日本経済は、中国をはじめとするアジア諸国の需要に対応した輸出に牽引される形で回復傾向にあるものの、アメリカやユーロ圏の景況感に不透明さが増してきているため円高傾向が継続し、日本経済の先行きに対して大きな重荷になっております。

当社が属する半導体関連業界では、今年の前半から大手半導体メーカーが設備投資を活発化させており半導体関連装置メーカーの受注高はリーマンショック以前のレベルに近づきつつあります。しかしながら前述のとおり先行きの不透明感が払拭できない中で、依然として設備投資に慎重な姿勢を崩さないメーカーも多く、予断を許さない状況が続いております。

このような状況のもと、当社は、主力製品の基板AOIを中心に、従来製品のファイン対応BGA検査装置及びリードフレーム検査装置等の受注獲得に努めてまいりました。また、継続して徹底した経費削減に努め、厳しい中でも利益を出せる体質を実現するべく取り組んでまいりました。

研究開発活動では、基板AOIの機能強化のための開発に注力するとともに、前事業年度に経済産業省から採択いただいた「戦略的基盤技術高度化支援事業」並びに「ものづくり中小企業製品開発等支援補助金」の両プロジェクトを中心に、次世代向けの画像処理システム及び関連技術の開発を実施しております。

この結果、売上高は2億27百万円(前年同四半期比778.5%増)、営業利益13百万円(前年同四半期は営業損失62百万円)、経常利益9百万円(前年同四半期は経常損失62百万円)、四半期純利益8百万円(前年同四半期は四半期純損失61百万円)となりました。

(2) 財政状態に関する定性的情報

当第1四半期会計期間末における資産の部は、前事業年度末に比べ91百万円増加し、10億59百万円となりました。これは主に、現金及び預金が49百万円増加し、受取手形及び売掛金が34百万円増加したことによるものであります。

負債の部では、前事業年度末に比べ82百万円増加し、7億88百万円となりました。これは主に、長期借入金が1億23百万円増加し、支払手形及び買掛金が34百万円増加し、短期借入金が1億円減少したことによるものであります。

純資産の部では、前事業年度末に比べ8百万円増加し、2億70百万円となりました。これは、四半期純利益8百万円を計上したことによるものであります。

(キャッシュ・フローの状況)

当第1四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税引前四半期純利益の計上等により、営業活動によるキャッシュ・フローがプラスとなり、また、借入れの純増等により、前事業年度末に比べ49百万円増加し、当第1四半期会計期間末には1億83百万円となりました。

当第1四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果獲得した資金は10百万円(前年同四半期は96百万円の使用)となりました。これは主に、税引前四半期純利益9百万円を計上したことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は0百万円(前年同四半期は2百万円の収入)となりました。これは、保険積立金の積立によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果獲得した資金は38百万円(前年同四半期は3百万円の使用)となりました。これは、長期借入金1億38百万円の純増及び短期借入金1億円の減少によるものであります。

(3) 業績予想に関する定性的情報

当第1四半期の業績については、概ね計画どおりに推移しており、受注及び生産状況につきましても、基板AOI及びBGA検査装置を中心に第2四半期で計画している売上について、概ね計画どおりに注文書又は発注内示書を入力し、生産している状況であります。

第2四半期以降の業績についても計画どおり推移する見込みであり、現時点での第2四半期累計期間及び通期の業績は、平成22年6月11日に発表いたしました業績予想と変更はございません。

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

①簡便な会計処理

定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっております。

②特有の会計処理

該当事項はありません。

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

資産除去債務に関する会計基準の適用

当第1四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針21号 平成20年3月31日)を適用しております。

これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ28千円減少しており、税引前四半期純利益は536千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は1,509千円であります。

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要

当社は、当第1四半期累計期間においては13,244千円の営業利益を計上しておりますが、前々事業年度において819,265千円の営業損失、前事業年度においても224,415千円の営業損失を計上しております。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

当社は、プリント基板の外観検査装置及びTABテープやBGA・CSP等の半導体パッケージの分野において、特に高い性能を要求されるハイエンドの分野に注力して、事業活動を展開しております。一昨年のリーマンショック以降、設備投資が極端に低迷しておりましたが、前事業年度後半から新製品を中心に引合いが増加し、受注も回復してまいりました。

当社は、事業環境の変化に柔軟に対応できる企業体質を構築するため、検査対象を半導体パッケージからプリント基板及び精密電子部品等に裾野を広げることで検査装置の製品ラインナップの拡充を図り、当社の強みであるファインパターン検査技術及び高速連続検査技術によって、ユーザーの検査ニーズに対する高度なソリューションを提供していくこと及びハイエンド分野で培った技術をベースとして、市場規模の大きい精密プリント基板市場に向けた製品戦略を展開することで、売上拡大を実現し、収益基盤の安定化を図ってまいります。

また、費用面においては、研究開発投資を戦略製品の開発に集中させることで、事業規模とのバランスを図る一方、組織のスリム化や業務フローの見直し等、業務全般の徹底した改善による効率化を図り、収益構造の改善を進めております。

資金面につきましては、引合いの増加、受注の回復が見えてきているとはいえ、今後の厳しい事業環境を踏まえ、これまで以上に主要取引金融機関に対して継続的な支援が得られるよう良好な関係を築き、資金調達や資金繰りの安定化に努めてまいりますので、資金面では問題はないと考えております。

しかしながら、これらの対応策は実施途上にあり、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

なお、四半期財務諸表は継続企業を前提として作成しており、このような継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を四半期財務諸表には反映しておりません。

3. 四半期財務諸表
(1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

	当第1四半期会計期間末 (平成22年7月31日)	前事業年度末に係る 要約貸借対照表 (平成22年4月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	183,581	134,256
受取手形及び売掛金	308,624	274,618
仕掛品	86,713	52,487
原材料及び貯蔵品	20,582	37,207
その他	6,451	9,621
貸倒引当金	—	△900
流動資産合計	605,953	507,291
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	370,077	375,100
その他(純額)	40,039	41,299
有形固定資産合計	410,116	416,399
無形固定資産	26,374	27,512
投資その他の資産	16,580	16,385
固定資産合計	453,072	460,298
資産合計	1,059,026	967,589
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	142,278	107,840
短期借入金	80,000	180,000
1年内返済予定の長期借入金	66,840	51,480
未払法人税等	1,922	5,773
製品保証引当金	7,687	6,962
その他	29,741	19,076
流動負債合計	328,469	371,133
固定負債		
長期借入金	429,480	305,860
その他	30,831	29,129
固定負債合計	460,311	334,989
負債合計	788,781	706,123
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,274,424	1,274,424
資本剰余金	605,524	605,524
利益剰余金	△1,609,703	△1,618,482
株主資本合計	270,245	261,466
純資産合計	270,245	261,466
負債純資産合計	1,059,026	967,589

(2) 四半期損益計算書
(第1四半期累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期累計期間 (自平成21年5月1日 至平成21年7月31日)	当第1四半期累計期間 (自平成22年5月1日 至平成22年7月31日)
売上高	25,906	227,594
売上原価	23,763	121,073
売上総利益	2,143	106,521
販売費及び一般管理費	64,391	93,277
営業利益又は営業損失(△)	△62,248	13,244
営業外収益		
保険解約返戻金	631	—
補助金収入	803	—
保険事務手数料	—	44
スクラップ売却益	—	87
その他	71	25
営業外収益合計	1,506	157
営業外費用		
支払利息	1,858	3,108
その他	50	744
営業外費用合計	1,908	3,853
経常利益又は経常損失(△)	△62,649	9,548
特別利益		
貸倒引当金戻入額	100	900
特別退職一時金戻入額	1,524	—
特別利益合計	1,624	900
特別損失		
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	508
特別損失合計	—	508
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)	△61,024	9,939
法人税、住民税及び事業税	974	974
法人税等調整額	△208	186
法人税等合計	766	1,161
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△61,791	8,778

(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第1四半期累計期間 (自平成21年5月1日 至平成21年7月31日)	当第1四半期累計期間 (自平成22年5月1日 至平成22年7月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失 (△)	△61,024	9,939
減価償却費	8,757	9,374
支払利息	1,858	3,108
売上債権の増減額 (△は増加)	19,593	△34,006
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△76,817	△17,601
仕入債務の増減額 (△は減少)	25,064	34,437
その他	△9,387	11,059
小計	△91,956	16,312
利息の支払額	△1,159	△1,798
法人税等の支払額	△3,811	△3,870
営業活動によるキャッシュ・フロー	△96,927	10,643
投資活動によるキャッシュ・フロー		
その他	2,742	△298
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,742	△298
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	—	△100,000
長期借入れによる収入	—	280,000
長期借入金の返済による支出	△3,000	△141,020
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,000	38,980
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△97,184	49,324
現金及び現金同等物の期首残高	184,356	134,256
現金及び現金同等物の四半期末残高	87,172	183,581

(4) 継続企業の前提に関する注記

<p>前第1四半期累計期間 (自平成21年5月1日 至平成21年7月31日)</p>	<p>当第1四半期累計期間 (自平成22年5月1日 至平成22年7月31日)</p>
<p>当社は、前々事業年度において23,891千円の営業損失を計上し、前事業年度においては売上高が530,154千円(前々事業年度2,059,634千円)と著しく減少するとともに、819,265千円の営業損失を計上しております。また、当第1四半期累計期間においても62,248千円の営業損失を引き続き計上しております。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。</p> <p>当社は、当該状況を解消するために、次のとおりビジネスモデル及び経営戦略の改革を実行し、事業の安定化及び財務体質の強化を図ってまいります。</p> <p>当社は、TABテープやBGA・CSP等の半導体パッケージ及びプリント基板の外観検査装置を主力製品としており、新製品開発のために先行して研究開発投資を実施しております。しかしながら、現在、半導体市場の需要の冷え込み及び価格の下落により、半導体関連の設備投資が抑制されており、当社をとりまく事業環境は急激かつ著しく悪化しております。</p> <p>当社は、このような事業環境の変化に柔軟に対応できる企業体質を構築するため、次の取り組みにより売上拡大を実現し、収益基盤の安定化を図ってまいります。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 検査対象を半導体パッケージからプリント基板及び精密電子部品等に裾野を広げることで検査装置の製品ラインナップの拡充を図り、当社の強みであるファインパターン検査技術及び高速連続検査技術によって、ユーザーの検査ニーズに対する高度なソリューションを提供してまいります。 2. FAシステム事業を再開し、ユーザーにおける生産プロセスの自動化ニーズへのソリューションを提供してまいります。 <p>また、費用面においては、研究開発投資を戦略製品の開発に集中させることで、事業規模とのバランスを図る一方、組織のスリム化や業務フローの見直し等、業務全般の徹底した改善による効率化を図り、更には人員の削減及び給与体系の見直しを実施したことで固定費を圧縮し、営業利益の改善を推進しております。</p> <p>資金面につきましては、今後の厳しい事業環境を踏まえ、これまで以上に主要取引金融機関に対して継続的な支援が得られるよう良好な関係を築き、資金調達や資金繰りの安定化に努めてまいりますので、資金面では問題はないと考えております。</p> <p>しかしながら、これらの対応策は実施途上にあり、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。</p> <p>なお、四半期財務諸表は継続企業を前提として作成しており、このような継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を四半期財務諸表には反映しておりません。</p>	<p>当社は、当第1四半期累計期間においては13,244千円の営業利益を計上しておりますが、前々事業年度において819,265千円の営業損失、前事業年度においても224,415千円の営業損失を計上しております。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。</p> <p>当社は、プリント基板の外観検査装置及びTABテープやBGA・CSP等の半導体パッケージの分野において、特に高い性能を要求されるハイエンドの分野に注力して、事業活動を展開しております。一昨年のリーマンショック以降、設備投資が極端に低迷しておりましたが、前事業年度後半から新製品を中心に引合いが増加し、受注も回復してまいりました。</p> <p>当社は、事業環境の変化に柔軟に対応できる企業体質を構築するため、検査対象を半導体パッケージからプリント基板及び精密電子部品等に裾野を広げることで検査装置の製品ラインナップの拡充を図り、当社の強みであるファインパターン検査技術及び高速連続検査技術によって、ユーザーの検査ニーズに対する高度なソリューションを提供していくこと及びハイエンド分野で培った技術をベースとして、市場規模の大きい精密プリント基板市場に向けた製品戦略を展開することで、売上拡大を実現し、収益基盤の安定化を図ってまいります。</p> <p>また、費用面においては、研究開発投資を戦略製品の開発に集中させることで、事業規模とのバランスを図る一方、組織のスリム化や業務フローの見直し等、業務全般の徹底した改善による効率化を図り、収益構造の改善を進めております。</p> <p>資金面につきましては、引合いの増加、受注の回復が見えてきているとはいえ、今後の厳しい事業環境を踏まえ、これまで以上に主要取引金融機関に対して継続的な支援が得られるよう良好な関係を築き、資金調達や資金繰りの安定化に努めてまいりますので、資金面では問題はないと考えております。</p> <p>しかしながら、これらの対応策は実施途上にあり、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。</p> <p>なお、四半期財務諸表は継続企業を前提として作成しており、このような継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を四半期財務諸表には反映しておりません。</p>

- (5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
該当事項はありません。